

证券代码：301338

证券简称：凯格精机

东莞市凯格精机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-010

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☒其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华创证券、华夏基金、中银基金、西部利得基金、淳厚基金、长江养老、长盛基金、富安达基金、华西基金、百嘉基金、宽源基金、财通基金、国泰海通资管、国信资管、首创资管、红土创新、光大保德信、国任保险、和谐健康保险资管、建信理财、陆家嘴信托、深圳市红筹投资、瓦洛兰投资、上海水璞私募、晨曦投资、敦和资管、中信建投等 70 位投资者
时间	2025 年 11 月 27 日 2025 年 11 月 28 日
地点	公司会议室、电话会议
上市公司接待人员姓名	投关经理 江正才
投资者关系活动主要内容介绍	公司基本情况介绍： 江正才先生详细介绍了公司主营业务、技术优势和研发创新情况。 公司与调研人员就以下问题进行了探讨： 1、面对下游需求的高端化趋势，公司认为自身的核心竞争壁垒主要体现在哪些方面？

答：公司秉承着“卓越品质是价值与尊严的起点，满足客户是创新与发展的源泉”的价值理念，始终将技术创新作为公司可持续发展的基石。公司从创立之初就注重研发中心的建设与完善，以共性技术研发为基础平台，结合创新型矩阵式产品管理孵化体系，致力于把研发中心打造成产品孵化中心。研发中心下设七大共性技术模块，包括软件工程、图像工程、运动控制、机械工程、电气工程、CAE 工程和系统集成，以高技术产品和垄断型产品为公司研发方向，结合高效的产品研发管理体系，将研发端、工艺端、产品端及市场端进行有机结合，促进技术成果的应用转化，提高公司产品的技术水平和竞争优势。

公司是国家级高新技术企业，荣获国家制造业单项冠军企业、专精特新“小巨人”企业，公司的锡膏印刷设备技术能力已达到或超越国际顶尖厂商水平，固晶设备在芯片小型化趋势上设备效率及稳定性的具有竞争优势，点胶设备通过技术的积累及产品的迭代升级，产品竞争力不断提升。

2、请简要介绍公司营业收入同比增长较快的原因

答：报告期内，公司营业收入实现增长，主要系锡膏印刷设备验收金额同比增加所致。

近年，下游电子制造行业中电子装联设备需求主要受到以下因素影响：

- ①人工智能投资规模扩大:2025 年全球 AI 基础设施投资加速，带动 AI 服务器市场需求强劲增长，进而增加了对电子装联设备的需求。
- ②消费电子需求回暖：IDC 报告显示，2025 年第三季度全球智能手机出货量同比增长 2.6%，PC 出货量同比增长 9.4%。终端市场复苏拉动了 PCBA(印制电路板组装)中 SMT(表面贴装技术)环节的设备投资。

③新能源车渗透率提升：汽车电子化趋势持续，促进了 SMT 设备采购。

3、锡膏印刷设备的市场占有率还有提升空间吗？

答：锡膏印刷设备属于 SMT 及 COB 产线的关键核心设备，一般用到 PCB、FPC 和电子元器件的地方均会涉及，对产品的良率有重大影响。PCB 的应用领域伴随着工业领域自动化、智能化需求的不断提升，公司的锡膏印刷设备下游扩展至 AI 终端、汽车电子、AR/VR、智能穿戴、智能家居、安防等新兴行业，需求总量增加。近年来我国电子装联设备国产替代进口的进程不断加速，公司在锡膏印刷设备高端市场的占有率有望持续提升。依托新加坡子公司 GKG ASIA 覆盖并由其为海外客户提供技术支持与服务，子公司在马来西亚、越南、印度、墨西哥等电子行业集中的境外市场区域设立了服务网点，为海外客户提供优质服务。

4、公司境外业务增速亮眼，收入占比持续提升。在当前复杂的国际经贸环境下，公司如何展望未来海外市场的增长潜力？

答：公司自 2007 年开始关注海外市场，在全球七十多个国家和地区注册了商标“GKG”，产品销往全球五十多个国家与地区，公司品牌和市场地位具有国际影响力。公司目前已构建覆盖全球的营销网络与技术支持服务体系，依托新加坡子公司 GKG ASIA 为海外客户提供技术支持与服务，并在马来西亚、越南、印度、墨西哥等电子行业集中的境外市场区域设立了服务网点。未来公司还将继续加大海外市场的拓展力度，为公司的业绩做出贡献。

5、公司的产品可以应用于 PCB 的哪些环节？

答：公司的锡膏印刷设备、点胶设备、柔性自动化设备可应用于电子工业制造领域的电子装联环节，电子装联行业下游

	应用极为广泛，一般用到 PCB、FPC 和电子元器件的地方均会涉及到电子装联。 锡膏印刷设备主要应用于 PCB(印制电路板)的 SMT 及 COB 工艺中的印刷工序，通过将锡膏印刷至 PCB/基板上，进而实现电子元器件/裸芯片与 PCB 裸板/基板的固定粘合及电气信号连接，属于 SMT 及 COB 工艺中的核心环节。 点胶设备主要应用于 PCB（印制电路板）的 SMT 工艺中的点胶工序，主要是通过将胶水喷射在 PCB 板或者元器件上，实现电子元器件与 PCB 板的固定、粘合、包封及填充，具有防水、防尘、散热、防震、保护等作用，为 SMT 的基础生产工序之一，对产品的品质、寿命等具有重要影响。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 11 月 28 日